

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月15日(15.05.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/100216 A1

(51) 国際特許分類:
C09K 3/10 (2006.01) *C08L 83/07* (2006.01)
C08L 27/12 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/037521

(22) 国際出願日: 2024年10月22日(22.10.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-192368 2023年11月10日(10.11.2023) JP

(71) 出願人: 株式会社バルカー (VALQUA, LTD.)
[JP/JP]; 〒1416024 東京都品川区大崎二丁目1番1号 (JP).

(72) 発明者: 大住 直樹 (OSUMI, Naoki); 〒6370014 奈良県五條市住川町テクノパーク・なら工業団地5-2 株式会社バルカー内 (JP). 木下ひろみ (KINOSHITA, Hiromi); 〒6370014 奈良県五條市住川町テクノパーク・なら工業団地5-2 株式会社バルカー内 (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人深見特許事務所 (FUKAMI PATENT OFFICE, P.C.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号 中之島フェスティバルタワー・ウエスト (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: SEALING MATERIAL COMPOSITION AND SEALING MATERIAL

(54) 発明の名称: シール材組成物およびシール材

(57) Abstract: The present disclosure relates to: a sealing material composition containing a fluorine elastomer, a silicone polymer having a vinyl group, and a crosslinking agent; a sealing material containing a crosslinked product of the sealing material composition; a gate seal for a semiconductor manufacturing device including the sealing material; and a semiconductor manufacturing device. The present disclosure provides: a sealing material composition that can exhibit an improved 100% modulus; a sealing material containing a crosslinked product of the sealing material composition; a gate seal for a semiconductor manufacturing device including the sealing material; and a semiconductor manufacturing device.

(57) 要約: 本開示は、フッ素エラストマー、ビニル基を有するシリコンポリマー、および架橋剤を含むシール材組成物、シール材組成物の架橋物を含むシール材、シール材を含む半導体製造装置用ゲートシールおよび半導体製造装置に関する。本開示によれば、向上した100%モジュラスを発揮することができるシール材組成物、シール材組成物の架橋物を含むシール材、およびシール材を含む半導体製造装置用ゲートシールおよび半導体製造装置が提供される。

WO 2025/100216 A1